



249618

P A T E N T E
D E
I N V E N C I O N

a favor de Don Venancio LÓPEZ DE CEBALLOS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Lincoln, 29, por "PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS METÁLICAS AUTOADHESIVAS".

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. La presente invención se refiere a un procedimiento especialmente estudiado para la fabricación de placas metálicas autoadhesivas, es decir, que tienen la propiedad de poderse adherir directamente sobre cualquier superficie, tal como superficies metálicas, de madera, vitrificadas, camaltadas, etc.

10. Como es sabido, en muchos casos se requiere la fijación de placas metálicas sobre dichas superficies (fijación de placas de características en motores y máquinas, señalación de butacas en espectáculos públicos,

249618



5. marcado de manufacturados y similares), lo que representa, generalmente, el tener que sujetar dichas placas por medios que afectan a la integridad de las propias superficies, tales como remaches, tornillos o análogos, todo ello en detrimento, tanto de la placa y superficie de fijación, como de la presentación del conjunto, que queda notablemente alterada.

10. Mediante el proceso objeto de la invención, se logra formar unas placas autoadhesivas, las cuales, gracias a su constitución, pueden ser fijadas sobre aquellas superficies como una simple etiqueta engomada, lo que, como es natural, tiene una gran importancia, en los casos antedichos y abre un campo inmenso de aplicación a dichas placas metálicas.

15. El procedimiento objeto de la invención consiste esencialmente en partir de chapas de aluminio oxidado electrolíticamente, coloreadas convenientemente y de espesor variable, de acuerdo con la aplicación que deba tener, sobre cuyas chapas se imprimirán los diseños y leyendas adecuados, procediendo luego a recubrir la superficie de su reverso con una capa de un material adhesivo de composición especial a base de cauchos sintéticos disueltos en determinados solventes orgánicos de tipo cetónico y ésteres.

20. La aplicación de esta capa de material adhesivo puede realizarse por cualquier procedimiento apropiado, tal como mediante cilindro alimentado en continuo desde un depósito adecuado, pincel, pistola aerográfica o similar,



249618

cuidado siempre de que la capa depositada tenga un espesor lo más uniforme posible.

5. Una vez aplicada dicha capa adhesiva, se procede al secado natural o forzado de la misma, con lo que se logrará la evaporación de los solventes contenidos en la composición formándose entonces por recristalización y orientación molecular a la temperatura ambiente, el compuesto adhesivo, permanente.

10. Finalmente, las chapas así preparadas son cortadas mediante cizalla o matrices, de acuerdo con la forma que deban adoptar las placas metálicas para su aplicación específica.

15. Para la fijación de las indicadas placas así preparadas, se procede a una reactivación de la capa adhesiva seca por medio de solventes orgánicos de características analogas a los utilizados para la preparación de la misma, es decir cetónicos o ésteres, como también por calor, con lo que aquella capa recobrará propiedades de adhesividad, pudiendo fijarse la placa entonces por simple presión sobre el objeto que se desee.

20. Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales, formas y dimensiones de las placas obtenidas, superficies a que las mismas se adhieren, aplicaciones generales de dichas placas, y en general, todos cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre que no aparten al conjunto de su esencialidad.



249618

N O T A

Se reivindica como objeto de la presente patente de invención:

1. Procedimiento para la fabricación de placas metálicas autoadhesivas, que consiste esencialmente en partir de chapas de aluminio, de dimensiones adecuadas, las cuales son sometidas inicialmente a oxidación electrolítica y coloreado, imprimiendo en las mismas los gráficos y leyendas pertinentes y pasando luego a depositar en su cara posterior una capa de un material adhesivo a base de cauchos sintéticos disueltos en disolventes orgánicos de tipo cetónico y ésteres, tras de lo cual se seca la capa adhesiva natural o forzadamente, hasta lograr la evacuación total de los disolventes contenidos en el adhesivo, formándose entonces por recriminación y orientación molecular el compuesto adhesivo permanente, pasando después al troquelado de las chapas según la forma que deban presentar para su aplicación ulterior.

2. Procedimiento para la fabricación de placas metálicas autoadhesivas.

20. La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 8 de mayo de 1959.

Venancio LOPEZ DE CEBALLOS

p. a.